



中国科学院微电子研究所
Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences

所况介
绍

机构设
置

科研方
向

招生招
聘

创新文
化

党群园
地

研究生培
养

产
系

首页

联系

科研方向

科研成果

专利成果

学科建设

学术交流

在研项目

技术服务

联合实验室

公共技术中心

2009年6月17日 星期三 所在位置: 首页 >> 科研方向 >> 科研成果

中科院EDA中心1053个管脚FCBGA封装顺利通过测试

2009-05-18 | 【大 中 小】

由中科院EDA中心为中科院计算所互连交换芯片D5K Switch开发的1053个管脚Flipchip-BGA（见图1）日前顺利通过测试，该芯片用于863计划重大专项支持的曙光5000A高效能计算机。封装的D5K Switch芯片已于09年4月16日在计算所通过DSP测试，正在进行的功能测试表明该芯片工作正常。

目前国内高端封装设计和制造能力完全掌握在外资大厂手中，而且一般只针对量产服务，小型封装服务始终是业界一个重大难题。中科院EDA中心快速高端封装服务平台立足自主BGA封装设计，整合业界资源，采用分段加工的新流程为各科研院所和企业提供完整的小批量高端服务解决方案。在计算所开发FCBGA封装项目中，针对芯片32组信号共1053个管脚，中科院EDA中心开发设计12层FCBGA基板，分别委托Kyocera公司进行基板加工、ASAT公司进行Bumping and Assembly。该封装是国内首款自主设计1000pin以上的FCBGA。

中科院EDA中心快速高端封装服务平台于2007年设立，为各科研院所和企业提供完善封装服务方案。07-08年已为微电子所一室院创新项目“光学读出非制冷红外阵列传感器”提供封装技术服务。封装含有铈和玻璃窗口的气密性可伐合金外壳。

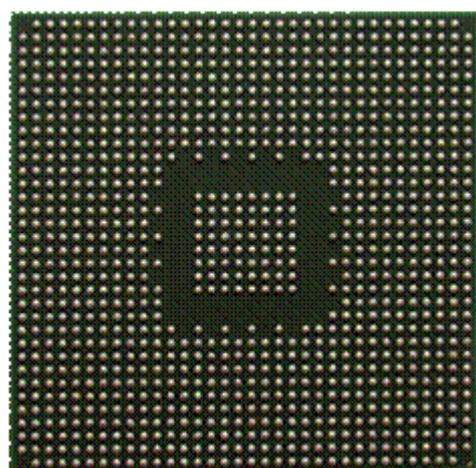


图1 1053管脚FCBGA封装的D5K Switch芯片

[>>返回](#)

[研究所概况](#) | [联系我们](#) | [科研体系](#) | [组织结构图](#) | [科研成果](#) | [网站地图](#) |

COPYRIGHT (C) 2007 Microelectronice of Chinese Academy of Sciences. ALL RIGHT RESSRVED
版权所有 中国科学院微电子研究所 京ICP备05002781号 最新更新日期: 2009-06-02 17:09:19